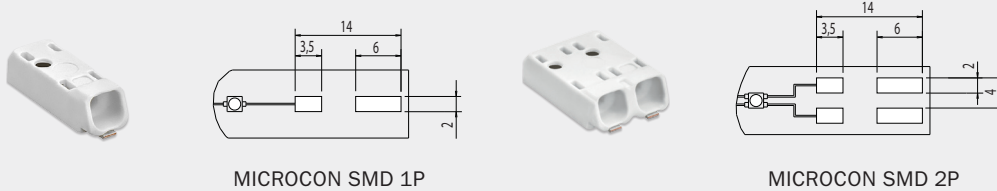


1. Produkt und Leiterplatten Lötbild | Product and PCB Layout

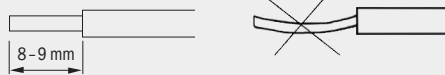
Empfohlener Lötpastenauftrag: > 0,12 mm
 Recommended min. stencil thickness: > 0.12 mm



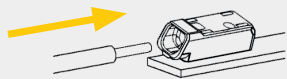
Kriech- und Luftstrecken sind durch den Einbau sicherzustellen. UL 1977: 3,175 mm; UL 1059: 4,3 mm; ÖVE: 1 Pol: 3,2 mm, 2 Pol: 1,6 mm.
 Creepage and clearance distances have to be maintained in the mounting process. UL 1977: 1/8 in; UL 1059: 11/64 in; ÖVE: 1 pol: 3.2 mm, 2 pol: 1.6 mm.

2. Leiter einführen | Wire insertion

Starre und flexible Leiter 0,2 – 0,75 mm²
 Rigid and flexible wires 0.2 – 0.75 mm²



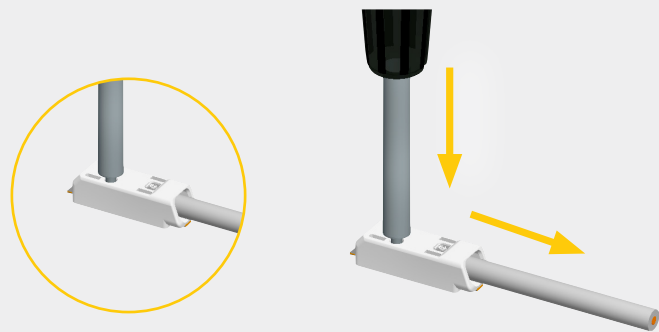
Abisolierlänge
 Wire stripping length



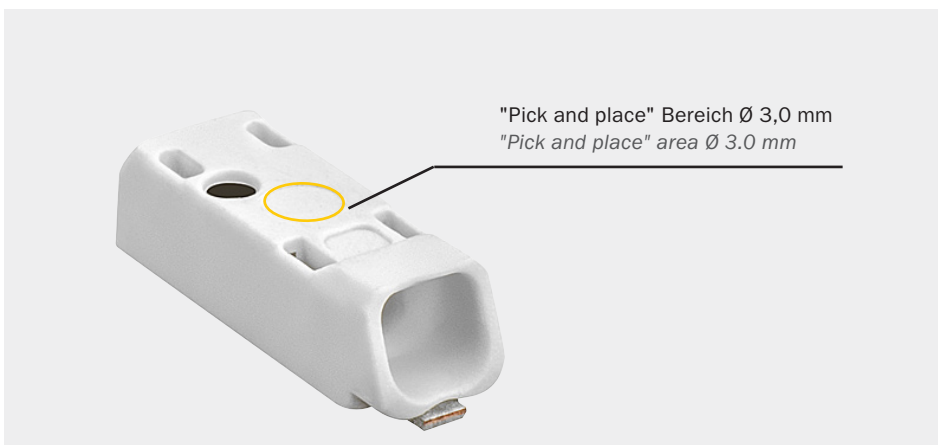
Leiter bis zum Anschlag einführen
 Insert wire completely to the stop

3. Leiter lösen | Wire release

Lösemöglichkeit mit Lösestift Art. Nr. 88167884 oder 0,5 mm² Draht
 Detachable with release pin art. no. 88167884 or 0.5 mm² wire



4. Pick & Place | Pick & place



"Pick and place" Bereich Ø 3,0 mm
 "Pick and place" area Ø 3.0 mm



MICROCON SMD
 Video auf YouTube
 Video on YouTube